**苏州工业园区集成电路产业政策申请表**

（流片补贴）

**类别: MPW□ /工程批□**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位基本情况 | 单位名称 |  | | 注册时间 | |  |
| 注册地址 |  | | | | |
| 法人代表 |  | | 是否总部 | |  |
| 职工人数 |  | | 研发人员数 | |  |
| 申报联系人 | 姓名： | | | 手机： | | |
| E-mail： | | | | | |
| 芯片类型 | □数字芯片 □模拟芯片 □数模混合芯片  其它 | | | | | |
| 设计工艺 |  | | | | | |
| 芯片描述 |  | | | | | |
| 芯片应  用领域 | 应用领域：  □汽车电子类 □医疗电子类 □通信类  □传感器类 □AI 人工智能类 □物联网类  □工业控制类 □消费类 □存储及信息安全类  其它 | | | | | |
| 主要研究方向： | | | | | |
| 流片厂商 |  | | 流片金额 | | 万元 | |
| 流片费是否申请过研发费加计扣除 | □是 □否 | | | | | |
| 企业法人代表（签章） 申请日期： 年 月 日 | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1、企业基本情况（包括企业基本概况、财务情况、整体研发水平等） |
| 2、产品研发说明（包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益等）： |

**苏州XX技术有限公司**

**2019年下半年申请集成电路设计流片补贴资金明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  （MPW/工程批） | 产品型号 | 流片厂商 | 发票信息 | | | | | | | | | |
| 发票号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额（含税，单位：元） | | | 开票日期 | 开票方名称 |
| 美元 | 汇率 | 人民币 |
| MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 工程批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | | | |  |  |  |  |  |